

実装業界の本流にアクセスする技術専門誌

エレクトロニクス

実装技術 2018/2019

Electronic Packaging Technology

Vol.34/35 年間特集予定表

月号	発行日	特集名	対象展示会	申込メ日	原稿メ日
----	-----	-----	-------	------	------

2018

9月号	8月20日	●部品搭載技術【創刊400号】	名古屋ネブコン・ジャパン (9/5~9/7)	7月20日	7月25日
10月号	9月20日	●電子部品	関西 設計・製造ソリューション展 (10/3~10/5) CEATEC JAPAN (10/16~10/19)	8月20日	8月27日
11月号	10月20日	●実装工程の効率化		9月20日	9月25日
12月号	11月20日	●半導体実装(3次元実装、その他)	ファインテック・ジャパン (12/5~12/7) SEMICON JAPAN (12/12~12/14)	10月22日	10月26日

2019

1月号	12月20日	●はんだ関連技術(インターネブコン号)	インターネブコン・ジャパン (1/16~1/18)	11月20日	11月26日
2月号	1月20日	●検査技術	nano tech (1/30~2/1) 設計・製造ソリューション展 (2/6~2/8)	12月20日	12月26日
3月号	2月20日	●プリント配線板/フレキシブルプリント配線板		1月21日	1月25日
4月号	3月20日	●製品製造現場	名古屋 設計・製造ソリューション展 (4/17~4/19)	2月20日	2月25日
5月号	4月20日	●環境関連技術		3月20日	3月26日
6月号	5月20日	●プリント配線板製造	JPCAショー、JISSO PUROTEC (未定) 画像センシング展 (未定)	4月22日	4月26日
7月号	6月20日	●設計・解析・シミュレーション		5月22日	5月27日
8月号	7月20日	●はんだ付け技術		6月20日	6月25日
9月号	8月20日	●部品搭載技術		7月22日	7月26日
10月号	9月20日	●電子部品	CEATEC JAPAN (未定) 関西 設計・製造ソリューション展 (未定)	8月20日	8月26日
11月号	10月20日	●実装工程の効率化		9月20日	9月25日
12月号	11月20日	●半導体実装(3次元実装、その他)	SEMICON JAPAN (未定)	10月21日	10月28日

※本内容は、編集の都合により変更になる場合もありますので、予めご了承下さい。

2018.06